

杭州士兰微电子股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会
会议资料



会议资料目录

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1、《关于控股子公司向中国进出口银行申请项目贷款的议案》 | 第 3 页 |
| 2、《关于对子公司增加担保额度的议案》 | 第 3 页 |

议案之一：

关于控股子公司向中国进出口银行 申请项目贷款的议案

公司已于 2015 年 4 月 22 日召开的 2014 年年度股东大会上审议通过了《关于拟投资建设 8 英寸集成电路芯片生产线的议案》：为抓住机遇加快公司集成电路芯片生产线的升级，提高公司产品的综合竞争能力，公司拟投资建设一条 8 英寸集成电路芯片生产线。公司重要控股子公司杭州士兰集成电路有限公司为该项目的实施主体。

为顺利推进公司 8 英寸集成电路芯片生产线的建设，杭州士兰集成电路有限公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请 5 亿元人民币或等值外币的项目贷款，贷款期限为 8 年。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 7 日

议案之二：

杭州士兰微电子股份有限公司 关于对子公司增加担保额度的议案

一、担保情况概述

2015 年 4 月 22 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于本公司 2015 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，根据该议案，公司 2015 年度拟为控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）提供不超过 50,000 万元的担保额度。

现根据士兰集成的生产经营和资金需求情况，为保证士兰集成的业务发展需要，公司拟向士兰集成增加担保额度 50,000 万元，即公司 2015 年度为士兰集成提供不超过 100,000 万元的担保额度，在以上担保额度内，签订的担保合同均为有效。

在股东大会批准上述担保事项的前提下,公司提请授权董事长陈向东先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1、公司名称: 杭州士兰集成电路有限公司

2、成立时间: 2001 年

3、注册地址: 杭州下沙经济技术开发区东区 10 号路 308 号

4、注册资本: 50,000 万元

5、法定代表人: 陈向东

6、经营范围: 经营范围为集成电路, 半导体, 分立器件的制造和销售; 自产产品及技术的出口业务; 经营生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务; 经营来料加工和“三来一补”业务。

7、投资主体的股东情况: 公司持有士兰集成 97%的股权, 公司全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司持有士兰集成 1.5%的股权, 公司参股公司杭州友旺电子有限公司持有士兰集成 1.5%的股权。

8、截至 2014 年 12 月 31 日, 士兰集成经审计的总资产为 100,887 万元, 负债 47,223 万元, 净资产 53,664 万元; 2014 年营业收入 101,930 万元, 净利润 8,225 万元。截至 2015 年 6 月 30 日, 士兰集成未经审计的总资产为 94,870 万元, 负债 43,489 万元, 净资产 51,381 万元; 2015 年半年度营业收入 43,416 万元, 净利润 2,717 万元。

三、公司担保情况

截止 2015 年 6 月 30 日, 公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 31,533.05 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 13.15%。除此之外, 公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 7 日